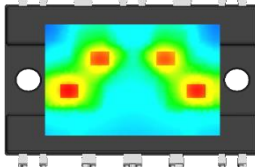
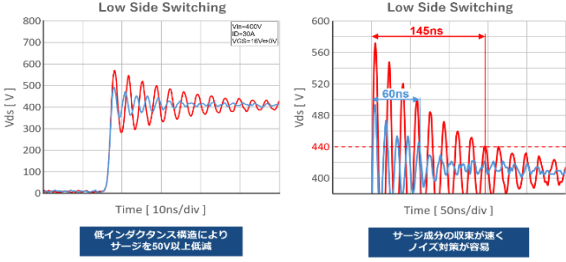


展示No	区分	<input checked="" type="checkbox"/> 部品 <input type="checkbox"/> 素材/材料 <input type="checkbox"/> 設備/装置 <input type="checkbox"/> 金型/治工具 <input type="checkbox"/> システム/ソフトウェア <input type="checkbox"/> その他( )		
11-1	提案名	SiCMOSモジュールMG074によるノイズ低減	工法	新規性
			-	業界最高水準
会社名	新電元工業(株)		所在地	埼玉県朝霞市幸町3-14-1
連絡先	URL : <a href="https://www.shindengen.co.jp/">https://www.shindengen.co.jp/</a>		Tel No. : 080-2280-9630	
部署名 : 営業本部マーケティング部販売促進課	E-mail : <a href="mailto:kamisaka@shindengen.co.jp">kamisaka@shindengen.co.jp</a>			
担当名 : 神坂 賢輔				
主要取引先	海外対応	海外拠点	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 有(国名 )	
国内大手tear1	<input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否			

<< 提案内容 >>

提案の狙い	適用可能な製品/分野				
<input type="checkbox"/> 原価低減 <input checked="" type="checkbox"/> 品質/性能向上 <input checked="" type="checkbox"/> 軽量化 <input type="checkbox"/> 安全/環境対策/CN対応 <input checked="" type="checkbox"/> 生産(作業)性向上 <input type="checkbox"/> その他( )	DC/DCコンバータ、OBC等				
従来	新技術・新工法				
①SiCMOSをディスクリートにて構成 ②スイッチング時にサージ電圧が発生する ③実装面積が大きい ④発熱がある ⑤ノイズ対策が必要 ⑥製品裏面～取り付け筐体間の絶縁が必要	①フルブリッジ部分をモジュール化 ②浮遊インダクタンス66%低減 (業界最高水準) サージ電圧50V低減 ③実装面積を40%低減 ④熱干渉の抑制及び絶縁型の高放熱構造を採用  ⑤サージ成分の収束が速くノイズ対策が容易  ⑥製品裏面～取り付け筐体間の絶縁が不要				
セールスポイント(製造可能な精度/材質等) ・浮遊インダクタンス66%低減 ・サージ電圧50V低減	問題点(課題)と対応方法 特になし				
開発進度 ( 2024 年 8 月 現在 ) <input type="checkbox"/> アイデア, <input checked="" type="checkbox"/> 試作/実験, <input type="checkbox"/> 開発完了, <input type="checkbox"/> 製品化完了	パテント有無 有				
従来との比較	項目	コスト	軽量化	生産/作業性	その他(品質)
	数値割合	-	-	-	浮遊インダクタンス 66%低減